

上海众辰电子科技股份有限公司

关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 交易金额：2026 年度向相关银行等金融机构申请总额为不超过人民币 90,000 万元的综合授信额度。
- 本交易不构成关联交易。
- 本事项尚需提交公司股东会审议。

一、申请综合授信的情况概述

为满足公司经营和发展的需要，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含合并报表范围内的子公司）拟在 2026 年度向相关银行等金融机构申请总额为不超过人民币 90,000 万元的综合授信额度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等综合授信业务。

本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定，以实际签署合同为准，有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。在上述额度范围内，无需另行召开董事会审议批准。

在上述授信额度内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调配，最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

二、申请综合授信审议程序

公司于 2026 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2026 年银行授信额度授权的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年年度股

东会审议，同时董事会提请股东会授权董事长张建军先生全权代表公司及子公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会

2026年4月23日